

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位及人员	诺安基金-周小琪 千禾基金-孙柯 民生加银-李君海 泰康资产-段中喆 银华基金-张晏铭 千禾基金-刘炆 长城基金-杨维维 长城基金-陈渭文 长城基金-储雯玉 长城基金-廖瀚博 长城基金-张捷 长城基金-韩林 欣荣拓展-沈喆强 富国基金-孙权 富国基金-王帅 兴业基金-刘体劲 中庚基金-陆伟成 永盈基金-任思儒 中欧基金-朱啸宇 华泰保险-叶文强 华宝基金-曹旭辰 汇丰晋信-刘昱辰 汇添富基金-陈淳 中邮证券-吴文吉 中邮证券-翟一梦 国信证券-张大为
时间	2024年11月13日
地点	电话会议、机构会议室
接待人员	董事会秘书常亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、大直径硅材料业务的增量市场空间 大直径硅材料业务是公司创立至今的核心业务，是主要的营业收入和利润来源，在产能和技术两方面都处于全球细分市场领先地位。2024年以来，该业务通过海外硅零部件制造厂客户，切入了海外市场先进制程芯片的产能扩张和稼动率

提升，间接受益于海外科技巨头在人工智能领域的持续巨额投资，因此业绩有所回暖，未来存量应用的市场空间仍有机会继续扩张。

公司还注意到以下市场增量变化：

1. 目前存储芯片的两大主要产品类型——DRAM和NAND Flash——之高端产品类别，例如HBM和eSSD，为满足人工智能高性能所需，都在沿着垂直堆叠的技术路线发展。为建立信号连接，芯片制造前道工序中深孔刻蚀工艺（TSV, Through Silicon Via）的用量相应增加；另外一方面，后道封装工序的先进封装工艺特别是CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）封装工艺中，为建立各类芯片之间的连接，也需要对硅中介层进行深孔刻蚀。因此，定性来看，等离子刻蚀的用量将增加，成为大直径硅材料业务的增量市场需求；

2. 随着近年中国本土集成电路制造产能的迅速扩张，特别是以长江存储、长鑫存储为代表的国产存储厂商对新增产能的资本开支和存量产能爬坡，拉动国产等离子刻蚀机台出货和运行，带动大直径硅材料业务的增量市场需求；

3. 随着先进制程逻辑芯片电路特征线宽向2nm迈进，前道工艺对等离子刻蚀机腔体内的Particle和杂质污染更加敏感。因此，国内外等离子刻蚀机原厂推出的先进机型，将原有的非硅材质零部件替换为单晶硅或多晶硅材质的需求增加，且对超大直径硅材料提出更高要求，带动大直径硅材料业务的增量市场需求。

目前，海外大直径硅材料市场尚未完全恢复。公司大直径硅材料产能全球领先，具备充分的产量提升空间，有能力满足未来半导体行业景气度提升后产生的下游市场需求。

二、 大直径硅材料业务毛利率

公司大直径硅材料业务的毛利率主要受益于成本端优化。

根据公司于2024年5月11日披露的公告《锦州神工半导体股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对锦州神工半导体股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函〉的回复公告》之“问题二、关于毛利率”的答复，公司2022年度和2023年度采购入库的高纯度多晶硅金额分别为10,425.56万元和169.91万元，平均采购价格分别为254.70元/千克和283.19元/千克。公司2023年度生产用多晶硅等原材料主要采购自2022年。

今年年初以来，随着下游市场回暖和订单增加，公司大直径硅材料产量环比

持续增加，原有多晶硅原料消耗速度加快并接近安全库存。因此，公司已按需采购市价多晶硅，成本端持续优化。

目前，高纯度多晶硅原料价格仍处于历史低位区间，开工率提升摊薄了产品单位成本，新产品的生产良率显著提升。综上，公司大直径硅材料业务毛利率有望继续保持稳健改善的态势。

三、 大尺寸半导体硅片业务进展

根据全球半导体硅片大厂SUMCO和GlobalWafers最新的第三季度数据：全球半导体硅片市场除个别与人工智能强相关的应用以外，下游客户普遍库存较高，库存消耗速度较慢，价格下跌。另据SEMI数据，预计2024年全球半导体硅片出货面积将减少2%。因此，国产半导体硅片厂商市场价格和空间受到进一步挤压，普遍面临较大的经营压力。

针对当前行业态势，公司管理层综合研判，对大尺寸半导体硅片业务采取了积极务实的经营策略：目前正片产品在主流大厂仍处于评估验证阶段，公司综合考虑评估验证和经济效益的平衡，年内持续优化排产计划，降低了可变成本，减少了该业务亏损金额，取得显著成效；公司除了在主流大厂验证以外，还根据一些特色工艺厂商的需求实施定制研发，取得评估认证机会和订单，价格较普通产品更为有利，为进一步取得国内较高毛利的新兴利基市场奠定基础。

公司所拥有的8吋轻掺抛光硅片产能，国内竞争对手相对较少，且国外大厂正在减产，因此具备一定市场空间。公司未来将根据市场实际情况，继续采取积极务实的经营策略，减少该业务在当前市况下的亏损，推动评估认证，争取早日实现盈亏平衡。

四、 硅零部件业务的增量市场空间

硅零部件业务是公司依托原有的大直径硅材料业务，向下游自然延伸的新业务，面向中国国内市场销售，近年来增长迅速。这主要得益于中国本土集成电路产能的巨额投资，带动了下游国产等离子刻蚀机原厂出货，相应地拉动了公司作为硅零部件OEM厂商的出货，拉动了硅零部件增量市场；此外，中国本土集成电路厂商受益于国内市场家电消费等市场回暖，今年以来开工率持续提升，拉动了硅零部件存量市场。

根据国内龙头代工厂中芯国际和华虹宏力近期披露的第三季度报告，开工率

	<p>已达到100%左右；国产存储厂商的DDR4和消费级SSD等大宗存储芯片产品也已经开始影响国际市场格局，开工率和产能提升较大。</p> <p>中国本土集成电路产能的高资本开支和高开工率，以及国产等离子刻蚀机厂商赶超国际先进水平的研发投入，有望带来持续需求，有利于公司硅零部件业务的快速发展。</p> <p>五、 硅零部件业务毛利率</p> <p>公司硅零部件业务的毛利率，在 2023 年度已经达到并超过了韩国同行业厂商的长期平均水平。这一方面是因为公司从晶体到加工的一体化技术实力和定制性开发能力较强，另一方面也受益于国产化浪潮下的优良产品结构，为中国集成电路制造国产自主做出了独特贡献。目前，公司在手订单充足，正在积极扩产，将努力确保在更高交付量下的较高良率，争取继续保持 2023 年度以来的毛利率水平。</p> <p>六、 外延式发展</p> <p>公司注意到，“并购六条”发布以来，半导体材料行业内已有多起并购案公开披露，大多为同一控制下的大股东资产注入。</p> <p>根据国际半导体材料行业的发展历史，优质企业需要在做好内涵式发展的同时，通过外延式发展获得更快的成长加速度，公司亦不例外。公司将在不断夯实主业的大前提下，积极探索国内外行业内的协作机会，注重资产质量以及主业协同性，扎实稳妥地推进外延式发展，为股东带来更好的回报。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 11 月 15 日